



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、組込みシステム開発技術展において、 パートナーとの共同開発による最新 IoT ソリューションを公開

2017年5月2日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は、5月10日から12日まで、東京ビッグサイトで開催されるJapan IT Week 春の「組み込みシステム開発技術展(ESEC)」に出展いたします。同展では、私どものIoTエコシステムパートナーと共に開発した最新IoTイノベーションを披露いたします。VIAブース#W1-26では、スマート運輸、スマート・ホーム、スマート・セキュリティ、4Kスマート・サイネージなど、幅広いアプリケーションをご覧いただけます。

同展では、VAB-630 3.5"ボードをベースに、スマート農業など幅広いIoT展開に最適なソリューションを実現するLoRaアクセラレーションモジュールなども展示予定です。



なお、同展において公開予定のパートナーとの共同開発によるソリューションは、以下のとおりです。

グリーンハウスおよび菱電商事と共同開発したVIA VAB-630 3.5"ボードと新しいLoRaモジュールをベースとしたスマート農業ソリューション。農家が収穫量を最適化するために重要なフィールドデータを収集・分析できるようにします。

VIA AMOS-820をベースに、VIA Smart ETKを活用したスマート運輸ソリューション：
ドアが開いていたり、バックの際に障害物が近くにあったりした場合など、GPIOピンを介して接続されたさまざまなセンサーからの信号を収集して、ドライバに情報を通知する車載システム

VIA、組込みシステム開発技術展において、 パートナーとの共同開発による最新 IoT ソリューションを公開

2/2

MAPPLE、NAVITIME、インクリメントPの主要ナビゲーション・ソフトウェア・ベンダーとともに共同開発したVIA AMOS-825をベースにした商用車用向けスマート・ナビゲーション・ソリューション

このほか、VIAブースでは、スマート・インダストリー、スマート運輸、スマート・エンタープライズの幅広いアプリケーションを対象とした、コンパクトな組み込みボードおよびシステムの最新ラインナップをご覧いただけます。

出展概要: Japan IT Week 春「組込みシステム開発技術展」

期間: 2017年5月10日(水曜日)~12日(金曜日)

開催時間: 10:00~18:00(最終日のみ 17:00 終了)

開催場所: 東京ビッグサイト W1-26

イベント URL: http://www.esec.jp/To-Visit_Haru/

組込みシステム開発技術展におけるVIA Technologyの出展内容などについては、下記URLをご参照ください。

<http://www.viatech.com/ja/about-ja/events-2017/esec/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットホームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたるM2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIAの国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス: RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス: press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIAはすべて大文字で表記してください。